

## DIAPOL 509 FT

**CLASE TÉRMICA B (130°C)**  
**-50 + 130°C**

Resina de poliuretano sin cargas que endurece mediante la adición del CATALIZADOR 500 y forma una masa muy flexible.

### APLICACIONES

DIAPOL 509 FT se emplea indistintamente para encapsulados o rellenos de componentes electrónicos que requieran de una masa aislante. Además, como relleno de condensadores anti-explósión.

### PREPARACIÓN Y ENCAPSULADO

La polimerización se efectúa a temperatura ambiente. En caso de que se desee más rapidez en el secado, puede acelerarse mediante aportación de temperatura (40-60°C). La proporción de mezcla recomendada es 100/40. En caso de querer obtener una versión tipo gel se podrá variar la proporción entre 100/25 y 100/40, determinando el valor de la proporción según las necesidades de acabado que requiera la aplicación final.

Aconsejamos mantener los envases bien cerrados para evitar la absorción de humedad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES	UNIDADES	DIAPOL 509 FT	CATALIZADOR 500
Viscosidad a 25°C	mPa·s	1000 ± 100	200 ± 20
Densidad a 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1.04 ± 0.1	1.24 ± 0.1
Ratio mezcla en peso		<b>100/25-40</b>	
Resistencia a la tracción	MPa	4.5	
Elongación	%	72	
Dureza Shore A/D		72/20	
Temperatura de transición vítrea	°C	15	
Resistencia a la incandescencia a 4mm	grade	2	
Absorción de agua durante 30 días	%	0.60	
Resistencia dieléctrica	kV/mm	20	
Resistividad	Ω·cm	2.10 <sup>13</sup>	
Resistividad superficial en seco	Ω	4.10 <sup>12</sup>	
Constante dieléctrica		4.2	

### FORMA DE SUMINISTRO

En envases de hojalata de 1,5 y 25L.

En bidones de plancha de hierro de 200L.

Noviembre 2018